

招商证券股份有限公司关于
通富微电子股份有限公司重大资产购买
之 2016 年度持续督导工作报告书

独立财务顾问

CMS  招商证券

二〇一七年三月

独立财务顾问声明

招商证券股份有限公司接受上市公司委托，担任上市公司重大资产购买的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》、《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本报告书。

1、本报告书所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产购买的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在报告书中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读通富微电子股份有限公司发布的与本次交易相关的文件全文。

目 录

独立财务顾问声明.....	2
目 录	3
释 义	4
一、本次交易方案概述.....	6
二、标的资产的过户情况.....	6
三、交易各方当事人承诺的履行情况.....	7
（一）本次交易涉及的相关协议及履行情况.....	7
（二）本次交易涉及的承诺及履行情况.....	8
四、业绩承诺的实现情况.....	8
五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状.....	8
六、公司治理结构与运行情况.....	9
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项.....	10

释 义

在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

第一部分：常用词语		
上市公司/公司 /通富微电	指	通富微电子股份有限公司，曾用名南通富士通微电子股份有限公司
交易对方、AMD	指	Advanced Micro Devices, Inc.
AMD 中国	指	超威半导体（中国）有限公司
AMD 马来西亚	指	Advanced Micro Devices SDN.BERHAD
AMD 苏州	指	苏州通富超威半导体有限公司，曾用名超威半导体技术（中国）有限公司
AMD 槟城	指	TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd.，曾用名 Advanced Micro Devices Export SDN.BHD
产业基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
标的公司	指	AMD 苏州和 AMD 槟城
标的资产	指	AMD 苏州 85% 股权、AMD 槟城 85% 股权
本次交易、本次重大资产重组	指	通富微电现金收购 AMD 苏州 85% 股权、AMD 槟城 85% 股权的行为
富润达	指	南通富润达投资有限公司
通润达	指	南通通润达投资有限公司
钜天投资	指	钜天投资有限公司，英文名称 Sky Giant Investment Limited
《股权购买协议》	指	南通富士通微电子股份有限公司与 Advanced Micro Devices, Inc. 签署的《股权购买协议》
《共同投资协议》	指	《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之共同投资协议》
《售股权协议》	指	《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之售股权协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所中小板股票上市规则》
本报告书	指	《招商证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司重大资产购买之 2016 年度持续督导工作报告书》
独立财务顾问 /招商证券	指	招商证券股份有限公司
元	指	人民币元
第二部分：专业词语		
芯片	指	用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路

封装	指	将通过测试的晶圆加工得到独立芯片的过程，保护电路芯片免受周围环境的影响（包括物理、化学的影响），起着保护芯片、增强导热（散热）性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以沟通芯片内部与外部电路的作用
晶圆	指	多指单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成,是最常用的半导体材料，按其直径分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸等规格，近来发展出 12 英寸甚至更大规格，目前以 8 英寸为主流
OSAT	指	外包半导体封装测试（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）
APU	指	加速处理器，系一系列由 AMD 公司推出，将中央处理器和独显核心集成在一个晶片上的芯片产品
CPU	指	中央处理器
GPU	指	图形处理器
MCM	指	多芯片组件封装技术
BGA	指	球栅阵列封装
FCBGA	指	倒装芯片球栅阵列封装
FCPGA	指	倒装芯片针脚栅格阵列封装
FCLGA	指	倒装芯片栅格阵列封装
Bumping	指	凸块技术

本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

一、本次交易方案概述

本次交易为公司采用支付现金方式收购总部位于美国的跨国公司 AMD 所间接持有的 AMD 苏州以及 AMD 槟城各 85% 股权。

通富微电就本次交易在境内分别于 2015 年 10 月 10 日和 12 月 8 日投资设立了全资子公司通润达和富润达，并通过将其持有的通润达 100% 股权转让给富润达的方式间接持有通润达 100% 的股权。引进产业基金作为战略投资者，产业基金根据与通富微电签署的《共同投资协议》的约定向通润达和富润达增资，增资完成后，通富微电和产业基金分别持有富润达 50.52% 和 49.48% 的股权，富润达与产业基金分别持有通润达 52.37% 和 47.63% 的股权，通润达作为收购 AMD 苏州股权的主体；同时，2015 年 11 月 17 日通润达在香港投资的全资子公司钜天投资作为收购 AMD 槟城股权的主体。

本次交易完成后，上市公司控股 AMD 苏州和 AMD 槟城。

二、标的资产的过户情况

1、AMD 苏州过户情况

上市公司与交易对方 AMD 已完成了 AMD 苏州 85% 股权过户事宜。

2016 年 4 月 11 日，AMD 中国和通润达签署《股权转让协议》，AMD 中国将其拥有的 AMD 苏州 85% 的股权转让予通润达。

2016 年 4 月 11 日，AMD 苏州的股东签署《超威半导体技术（中国）有限公司修改及重述后的公司章程》，对相关条款作出相应修改。

2016 年 4 月 11 日，AMD 中国和通润达签署《合资合同》。

2016 年 4 月 14 日，苏州工业园区管委会下发《园区管委会关于超威半导体技术（中国）有限公司股权转让的批复》（苏园管复部委资审[2016]27 号），同意 AMD 中国将其持有的 AMD 苏州 85% 的股权及相应的权利义务、债权债务转让予通润达；同意 AMD 苏州性质由外商独资变更为中外合资。

2016 年 4 月 14 日，江苏省人民政府向 AMD 苏州换发了《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2016]49789 号），企业类型变更为“中外合资企业（外

资比例小于 25%)”，投资者变更为 AMD 中国和通润达。

2016 年 4 月 26 日，苏州工业园区工商局向 AMD 苏州换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91320594759661883L）。

2016 年 5 月 23 日，江苏省人民政府向 AMD 苏州换发了《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2016]49789 号），“超威半导体技术（中国）有限公司”名称变更为“苏州通富超威半导体有限公司”。

2016 年 5 月 23 日，苏州工业园区工商局向 AMD 苏州换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91320594759661883L），对企业名称作出相应变更。

2、AMD 槟城过户情况

上市公司与交易对方 AMD 已完成了 AMD 槟城 85% 股权过户事宜。

2016 年 4 月 29 日，AMD 马来西亚将其持有的 AMD 槟城每股价值 1 马来西亚林吉特的共 1,334,500 股普通股转让予钜天投资。

2016 年 7 月，“ADVANCED MICRO DEVICES EXPORT SDN. BERHAD”名称变更为“TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.”。

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司与交易对方已完成标的资产的交割及过户。

三、交易各方当事人承诺的履行情况

（一）本次交易涉及的相关协议及履行情况

2015 年 10 月 15 日，交易双方 AMD 与通富微电签署了《股权购买协议》；

2015 年 12 月 25 日，上市公司与产业基金签署《共同投资协议》；

2016 年 1 月 18 日，上市公司与产业基金签署《售股权协议》。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本报告书签署之日，上述协议均已生效并均得到了正常的履行，交易各方未出现违反协议约定的行为。

（二）本次交易涉及的承诺及履行情况

在本次交易过程中，各交易对方当事人所出具的主要承诺包括：交易对方、标的公司、上市公司关于提交信息真实、准确和完整的承诺；交易对方关于目标资产所有权的承诺；交易对方合法合规的承诺；交易对方规范关联交易的承诺；交易对方避免资金占用的承诺。

上述承诺的主要内容已在《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中予以披露。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本报告书签署之日，上述承诺均得到了正常的履行，相关承诺方未有违反上述承诺的情况。

四、业绩承诺的实现情况

本次交易的交易对方未做出业绩承诺。

AMD 与 AMD 苏州及 AMD 槟城于 2016 年 4 月 29 日分别签署了《协议书》（或称《利润目标协议》），协议约定：

AMD 同意其承诺支持 AMD 苏州及 AMD 槟城达成其中双方均可接受的、已经达成一致的预期目标，包括收入和利润目标（“利润”是指按美国通用会计准则计算、与 AMD 相关的息税前利润），利润目标为，自生效日起 36 个月内，每个财政年度 AMD 苏州及 AMD 槟城合计共 2,000 万美元。

《利润目标协议》的内容系上市公司与 AMD 在合理商业谈判的基础上所做出的切实可行的商业安排，未就利润目标未达成时的补偿措施进行约定。

截止 2016 年 12 月 31 日，该协议生效尚未满一个财政年度，从该协议的实际执行情况来看，2016 年 4 月本次交易标的资产交割及过户完成后，为完成《利润目标协议》中所述的利润目标，AMD 增加了对 AMD 苏州及 AMD 槟城的订单。

五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状

2016 年 4 月 29 日，在产业基金支持下，公司完成了收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85% 股权的交割工作，公司与 AMD 建立战略合作伙伴关系。本次交易提

高了上市公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于增加上市公司和广大中小股东的利益。

AMD 苏州及 AMD 槟城在先进封装领域具有较强的技术优势，经过多年的发展积累，形成了以倒装封装为主的技术线路，主要量产技术包括 FCBGA、FCPGA、FCLGA、MCM，其主要从事 CPU、GPU、APU、游戏机芯片等高端产品的封装测试。并购后，公司不仅获得了 FCBGA 等高端封装技术和大规模量产能力，使得公司能够提供品种最为完整的倒装芯片封测服务，同时，使得公司更有能力支持国产 CPU、GPU、网关服务器、基站处理器、FPGA（现场可编程门阵列）等产品的研发和量产，提前完成了在国产 CPU 产业链方面的布局。

完成股权交割以来，AMD 苏州、AMD 槟城运行稳中有进，新项目推进有序：

1、AMD 订单增加较快，产量同比 2015 年增长约 50%。

2、协同效应初见成效，吸引了 Broadcom、Samsung、Socionext 等高端客户。AMD 槟城顺利量产全球 TOP3 设计公司产品；AMD 苏州顺利量产国内 TOP3 设计公司产品，赢得第一个 AMD 以外的新客户，12 月已开始第一批量产；AMD 苏州和 AMD 槟城已成功迈出向 OSAT 转型的第一步。

3、AMD 与公司计划启动 Bumping 合作，加大双方合作及协同效应。

本次交易收购的 AMD 苏州和 AMD 槟城两家公司纳入合并范围给上市公司带来显著的利润增长。2016 年度，上市公司实现营业收入 459,165.67 万元，比上年同期增加 226,975.35 万元，增长 97.75%；利润总额 24,379.63 万元，比上年同期增加 8,197.56 万元，增长 50.66%；实现净利润 23,670.51 万元，比上年同期增加 8,937.97 万元，增长 60.67%。

经核查，本独立财务顾问认为：2016 年度上市公司各项业务的发展状况良好，本次重组的完成使得上市公司在报告期的营业收入及净利润有较大增长。

六、公司治理结构与运行情况

督导期内，上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上

市规则》等相关法律、法规和规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。上市公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理符合相关法律法规和规范性文件的要求。

经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组完成后，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等有关法律、法规和规则的要求，建立了符合法律法规和上市公司实际情况的法人治理结构。上市公司能够严格按照法律、法规、规章及公司治理的规章制度进行规范运作，并真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保护上市公司和股东的合法权益。

七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易各方已按照公布的重组方案履行相关责任和承诺，实际实施的重组方案不存在与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司重大资产购买之 2016 年度持续督导工作报告书》之签章页）

招商证券股份有限公司

2017 年 3 月 31 日